

2. ASIC Symposium

ASICs for a Smarter World

Do, 26. Oktober 2017

- Ab 9:30 Uhr Begrüßung der Teilnehmer in den Räumen der TH Bingen
- 10:00 Uhr **Eröffnung des 2. ASIC-Symposiums**
Prof. Dr.-Ing. Klaus Becker, Präsident der TH Bingen
- 10:15 Uhr **Mixed-Signal Design Challenges in Deep Submicron CMOS Technologies**
Dr. Sebastian Höppner, Dr. Stefan Hänzsche,
Professur für Hochparallele VLSI-Systeme und Neuromikroelektronik, TU Dresden
- 11:00 Uhr *Pause*
- 11:15 Uhr **The Art of Sensing - Solutions for Integrated Sensors**
Dr. Lutz Porombka, CREATIVE CHIPS GmbH
- 11:45 Uhr **IMEC's Service offer, TSMC Partnership & Update on TSMC BCD/HV & eNVM offering**
Marco Vrouwe, TSMC, Amsterdam
Paul Malisse, IMEC, Leuven
- 12:30 Uhr *Pause*
- 13:30 Uhr **PIRX (3D) - Pilotless Reconfigurable Experimental UAV**
Prof. Dr.-Ing. Jens Altenburg, TH Bingen
- 14:00 Uhr **Overview of Current Market Trends and Key Fastest Growing Packaging Technologies (i.e. SiP, WLP)**
David Clark, Amkor Technologies, Philippines
- 14:30 Uhr *Pause*
- 14:45 Uhr **Failure Analysis Going towards Anamnesis - A Holistic Approach for Successful Root Cause Detection**
Jürgen Gruber, Rood Microtec, Stuttgart
- 15:30 Uhr *Get Together / Möglichkeit einer Führung bei Creative Chips*
- ca. 16:30 Uhr *Ende der Veranstaltung*

Interessierte **Gäste sind herzlich willkommen**, ganz **besonders Studierende** (keine Einschränkung auf spezielle Studiengänge). **Anmeldung erforderlich**: bitte bis zum 23.10.17.

Ansprechpartner für TH Bingen: **Prof. Schultz** (schultz@th-bingen.de), Raum 1-210.